

エンプラ樹脂材料へのダイレクトめっき

<PR>

- ①現在、ポリイミド(PI)・テフロン(PTFE)にダイレクトめっきが可能です
- ②ポリイミド(PI)には、平滑なめっき皮膜の形成が可能です(PTFEは開発中)

<技術要旨>

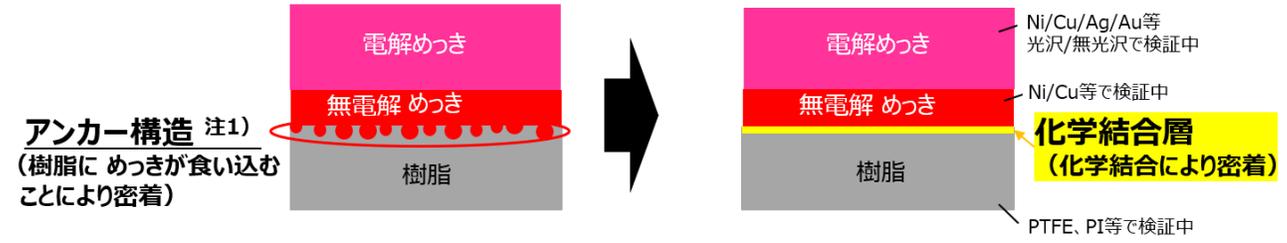
樹脂とめっき被膜の密着性確保のために、粗化によるアンカー効果ではなく化学結合層の成膜による工法を開発中です

従来技術

・アンカー構造により、樹脂と無電解めっき層とが密着

新技術(開発中)

・強力な化学結合を介して、樹脂と無電解めっき層とが密着



注1)アンカー構造:樹脂が粗化^{注2)}した凹部に、めっきが食い込んだ構造。この構造(アンカー構造)により強度が発現。

注2)粗化:化学的なエッチングや物理的なブラスト等がある。化学的な方法が有効であるが適用材料が限定される。

<めっき仕様>

無電解ニッケル-ボロン(Ni-B): $\sim 0.2\mu$
 電解銅めっき(Cu): $10\sim 20\mu$
 (下地 無電解めっき)

<開発中のエンプラ材料>

液晶ポリマー(LCP)、ポリフェニレンエーテル(PPE)
 シクロオレフィンポリマー(COP)
 ポリフェニレンサルファイド(PPS)
 パーフルオロアルコキシアルカン(PFA)

～不可能への挑戦～
 株式会社 友電舎
 大阪市此花区常吉2丁目4番8号
 TEL:06-6465-1663
 Mail:joho1@ydn.co.jp
 URL:http://www.ydn.co.jp

